

Technische Merkblatt

Easy Print /Sn62 Pb36 Ag2/

Die Paste No Clean- Typ eignet sich hervorragend zum Löten von SMD- Teilen bei Prozessen, bei denen keine Reinigungsphase berücksichtigt wurde. Das Produkt enthält als Bestandteil - außer Metallpulver - auch Flussmittel auf der Basis von Harzen und Lösemitteln, dazu auch Aktivatoren, die die Oxide beseitigen, tixotrope Zusatzstoffe, die Klebrigkeit und Plastizität garantieren.

Verwendung:

- Elektronik
- Elektrotechnik
- automatisches Löten
- manuelles Löten
- SMD-Montage
- bei automatischen Druckverfahren
- bei Hand-Druckverfahren

Physikochemischen Eigenschaften:

Eigenschaften	Wert	Standards
chemische		
Art. des Bindemittels	Sn62Pb36Ag2	
Flussmittelklassifizierung	REL - 0	J-STD - 004
Papierchromatographietest an C.I.	erfüllt (REL - 0)	IPC TM 650
physikalische		
Dichte	≈ 4,6 g/cm ³	IPC-TM 650T
Körnung	25-45 µm	IPC-TM 650T
Viskosität	1,0 G/mm ² po 24h	IPC J-STD - 005
Eignung zum Drucken	über 8h	
elektrische		
SIR-IPC	> 2,6*10 ⁹ Ω, Messung nach 7 Tagen	IPC J-STD 004 (85°C, w 85%)

Symbol:

SIR - Surface Insulation Resistance -Oberflächenwiderstand des Widerstands

IPC - J STD 004/ 005, IPC - TM650 - Amerikanische Standards, die technische Anforderungen an Pasten und Flussmittel definieren

Anwendungsanforderungen:

Lagerung	Drucken	Reflow-Löten	Waschen
<ul style="list-style-type: none"> Lagern bei einer Temperatur von 3-7 °C für einen Zeitraum von höchstens 6 Monaten in dicht verschlossenen Behältern, die beste (optimale) Temperatur zum Auftragen der Paste: 23-26 °C, max. Temperatur zum Auftragen der Paste 28 °C, um Änderungen der Schmiereigenschaften der Paste zu vermeiden, verbinden Sie die benutzte Paste nicht mit frischer Paste um Feuchtigkeitskondensation zu verhindern und die entsprechenden Eigenschaften der Paste zu erhalten, vor dem Öffnen einige Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Umgebungstemperatur annehmen lassen, lasergeschnittene oder elektroformte Schablonen 100 µm für Raster = 0,4 mm 150 µm für Raster => 0,5 mm Metallraket empfohlen Rakelgeschwindigkeit im Drucker: 25-150 mm/s Druck auf die Rakel: 1,5-3 N pro cm Länge Pastmenge auf der Schablone: 15-20 mm dicke Walze, die vor der Rakel rollt 	<ul style="list-style-type: none"> alle Lötmethoden sind möglich (in normaler Atmosphäre und in Stickstoff) Vorheizen: konstanter Anstieg von 1-2,0 °C/s auf Temperatur in Höhe von 145-160 °C oder max. 210-220 °C für die Version ohne Plateau Plateau-Phase (nur für Packungen mit hoher Dichte an Elementen unterschiedlicher Masse) 145-160 °C für 60-90 s Löten - Reflow-Phase: 30-90 s über 180 °C Kühlung: Gradient: 1-2 °C/s 	<ul style="list-style-type: none"> Paste als „no clean“ erfordert grundsätzlich kein Waschen wenn Waschen notwendig ist, empfehlen wir PCB Alkoholreiniger

Verpackung:

Kapazität	Art. der Verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
1,4 ml	Spritze	5	ART.AGT-023
20 g	Kartusche	1	ART.AGT-024
40 g	Kartusche	1	ART.AGT-025
250 g	Kunststoffbox	1	ART.AGT-031
500 g	Kunststoffbox	1	ART.AGT-027